



SOITEC ENTRE SUR LES MARCHES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET DU WI-FI AVEC LA PRODUCTION EN VOLUME D'UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE PLAQUES SOI HAUTE RÉSISTIVITÉ

Bernin, le 16 février 2010 - Soitec (Euronext Paris), premier fabricant mondial de plaques de silicium sur isolant (SOI) et autres substrats innovants utilisés en micro-électronique, lance la production en volume de sa nouvelle génération de plaques de silicium sur isolant (SOI) haute résistivité (HR) et haute performance pour les marchés en plein essor de la téléphonie cellulaire et des communications sans fil (Wi-Fi). Soitec a récemment été qualifié par plusieurs clients de premier plan pour fabriquer ces plaques en grandes quantités et ainsi répondre à leur demande en forte croissance. La société a affiné son procédé HR-SOI pour stabiliser la résistivité de la plaque de base afin de répondre à toutes les spécifications électriques des standards cellulaires.

La migration des téléphones mobiles actuels vers des fonctions radio multi-modes et multi-bandes et le développement des applications sans fil Wi-Fi contribuent à l'adoption de solutions SOI. Comparé aux technologies concurrentes, le HR-SOI permet une plus grande intégration et programmabilité tout en réduisant de façon significative le coût des modules RF d'émission réception. Pour le HR-SOI, la technologie Smart Cut™ de Soitec est utilisée avec un substrat de base haute résistivité, ce qui permet de limiter l'absorption de signal sous l'oxyde. Grâce à cette option « haute résistivité » des plaques SOI, les concepteurs de circuits intégrés peuvent atteindre des niveaux sans précédent d'intégration dans les circuits RF et analogiques mixtes, permettant ainsi de réduire par dix l'espace à forte valeur occupé par ces fonctions RF sur le circuit imprimé.

« Nos moyens de production de plaques HR-SOI sont en place pour répondre à la demande d'un marché cellulaire en plein essor », déclare Paul Boudre, Directeur général délégué (COO) de Soitec. « Cette nouvelle génération de plaques SOI permettra aux concepteurs de circuits intégrés de répondre aux exigences de performances des applications sans fil — faibles pertes des plaques RF, isolation élevée, haute linéarité — sur des circuits intégrés en silicium au coût optimisé ».

Les couches haute résistivité peuvent également être combinées à des technologies SOI avancées utilisant une couche de silicium supérieure de très faible épaisseur. Les plaques ainsi obtenues conviennent parfaitement pour regrouper sur un seul circuit des fonctions sans fil et une logique haute vitesse / basse consommation, en utilisant une technologie CMOS SOI standard.

Fabriquées en technologie 200 mm, les plaques HR-SOI de Soitec affichent une résistivité supérieure à 1 k Ω .cm et sont disponibles en toute épaisseur. La société propose par ailleurs des plaques HR-SOI en technologie 300 mm pour le marché des systèmes sur puce (System on Chip - SoC) pour des nœuds technologiques de 90 nm et en-deçà.

À propos de Soitec

Soitec est le leader mondial dans la fourniture de substrats innovants pour l'industrie microélectronique de pointe. Le groupe produit une gamme étendue de matériaux avancés, notamment les plaques de silicium sur isolant (SOI) basées sur sa technologie



Smart Cut™, la première application à fort volume de cette technologie. La technologie SOI apparaît aujourd'hui comme la plateforme du futur, ouvrant la voie à la production de puces plus performantes, plus rapides et plus économiques.

Aujourd'hui, Soitec fabrique plus de 80% des plaques de silicium sur isolant utilisées mondialement. Basé à Bernin, en France, où se trouvent deux unités de production à fort volume, Soitec possède des bureaux aux Etats-Unis, au Japon et à Taiwan, ainsi qu'un nouveau site de production à Singapour.

Le groupe comporte trois autres divisions : Picogiga International, Tracit Technologies et Concentrix Solar. Picogiga est spécialisé dans le développement et la fabrication de substrats innovants, depuis les plaques épitaxiées de semi-conducteurs III-V et les plaques à base de nitrure de gallium (GaN), jusqu'aux substrats composés pour la fabrication de dispositifs électroniques à haute fréquence ou optoélectroniques. Tracit est spécialisé dans la technologie de transfert de couches minces utilisée dans la production de substrats innovants destinés aux micro-systèmes et aux circuits intégrés de puissance, ainsi que dans la technologie Smart Stacking™ de transfert de circuit pour des applications telles que les capteurs d'image et l'intégration 3D. En décembre 2009, Soitec a acquis 80% de Concentrix Solar, l'un des premiers fournisseurs mondiaux de systèmes photovoltaïques à concentration (CPV). Soitec fait ainsi son entrée sur le marché en plein essor de l'industrie solaire en se positionnant sur la chaîne de valeur au niveau du système de production de l'énergie solaire.

Les actions du groupe Soitec sont cotées sur Euronext Paris.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet www.soitec.fr.

Soitec, Smart Cut, Smart Stacking et UNIBOND sont des marques déposées de S.O.I.TEC Silicon On Insulator Technologies.

Contact Presse française

Muriel Martin, H&B Communication
+33 (0)1 58 18 32 44
m.martin@hbcommunication.fr

Relations Investisseurs

Olivier Brice
+33 (0)4 76 92 93 80
olivier.brice@soitec.fr

Contact Presse internationale

Camille Darnaud-Dufour
+33 (0)6 79 49 51 43
camille.darnaud-dufour@soitec.fr